



参考基板レイアウト (マウント面)
 RECOMMENDED P.C.BOARD
 PATTERN DIMENSION. (REF.)
 (MOUNTING AREA)

- 補強金具 : 錫メッキ
 FITTING NAIL : TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
 補強金具下地メッキ : ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (FITTING NAIL)
 1.0 MICROMETER MINIMUM
- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
 APPLY FOR (CIRCUIT/2) = EVEN.
- 4 嵌合相手 : 53949 シリーズ
 MATE WITH : 53949 SERIES.
- 5 テール及びネールの平坦度は, 0.1MAX.
 TAIL AND NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.
- △ テール部に適用。
 APPLY TO THE TAIL AREA.
- △ ネール部に適用。
 APPLY TO THE NAIL AREA.
- 8 本製品は 54150-***1 の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54150-***1.
9. ELV及びRoHS適合品。
 ELV AND RoHS COMPLIANT.

注記 NOTES:
 1 使用材料 MATERIAL
 ハウジング : LCP ガラス充填 UL94V-0 (黒)
 HOUSING : LCP (GLASS FILLED) UL94V-0 (COLOR:BLACK)
 ターミナル : リン青銅 (t=0.15)
 TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
 補強金具 : リン青銅 (t=0.2)
 FITTING NAIL : PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)
 2 メッキ仕様 PLATING
 コンタクト部 : 金メッキ
 CONTACT AREA : GOLD
 テール部 : 金メッキ
 TAIL AREA : GOLD
 ターミナル部下地メッキ : ニッケルメッキ
 UNDER PLATING : NICKEL (TERMINAL AREA)
 0.25 MICROMETER MINIMUM
 0.4 MICROMETER MAXIMUM
 1.5 MICROMETER MINIMUM

20.5	19.5	23.9	54150-0878	80
C	B	A	EMBOSSED TAPE	CIRCUIT
			ORDER No. オーダー番号	
CONNECTOR No. 54150-**71				

REVISED EC NO. J2010-1976 DRWN: MWABEI 2008/07/10 CHKD: MATSUMOTO 2010/06/17 APPR: HIRATA 2010/06/18	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY H. KAWABATA	DATE '04/03/03	TITLE 0.5 B-TO-B REC HSG ASSY WITH FITTING NAIL			
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOJO	DATE '04/03/03	MOLEX INCORPORATED			
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/03/03				
A	REV	ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO. SEE TABLE		DOCUMENT NO. SD-54150-001		SHEET NO. 1 OF 1	
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					